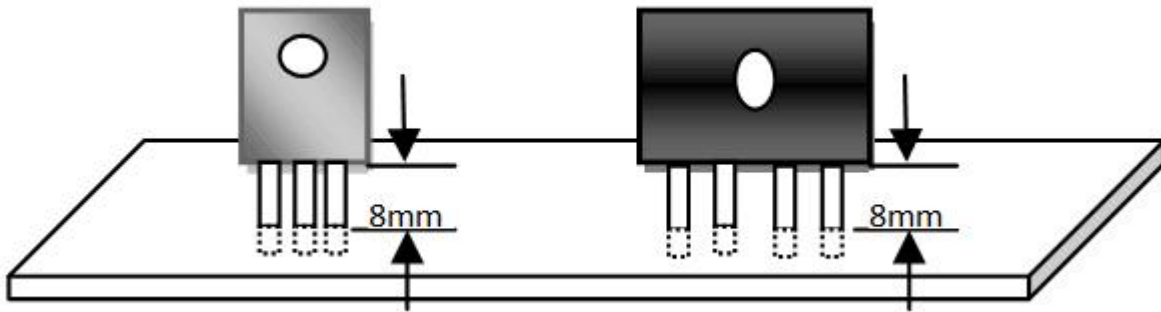


产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
步进驱动器	SD3228N	贴装焊接	QM005	V2	1/1	2017.05.02

SD3228N 贴装焊接要求：

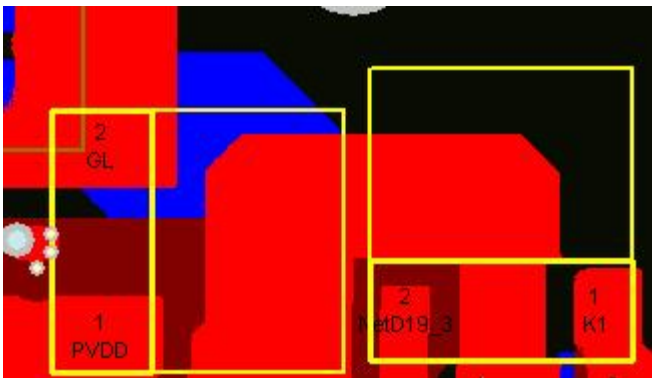
1) 两个固定在散热片插件（一个 MOS 管及一个整流桥）的焊接高度均为 8mm，且要求元件本体不能倾斜，与主板垂直，见下图：



2) R18 和 R78 ，焊接时，要距离线路板 1~2mm；

3) IPM 自身有高度定位；

4) C8 平躺焊接，见下图； C19 不焊接；



5) 端口插座不能浮高、歪斜，需与主板边缘平行；

6) 其他元件均紧贴主板焊接；

7) 插件管脚剪切后的长度不能超过 2mm；



8) 避免少件、多件、错件、虚焊、空焊、少锡、多锡、焊锡桥接现象

9) 元件贴装不能歪斜，确保极性元件的方向正确；

10) 主板清洗干净，不能有洗板液体的残留物，确保焊点明亮；